

单位: mil

## LPIBA88A

### 产品特性:

尺寸

芯片尺寸: 8mil x 8mil  
(205±20μm x 205±20μm)

芯片厚度: 7.6mil(190±25μm)

焊盘尺寸: 3.6mil(90±10μm)

焊盘金属

P焊盘: 金

N焊盘: 铝



LatticePower

产品介绍  
Product Introduction



# LPIBA88A



LatticePower

产品介绍  
Product Introduction



# LPIBA88A

## 最大额定值

DC正向电流	30mA
正向峰值电流(1/10占空比@1kHz)	100mA
LED结温	125℃
反向电压	5V
使用温度范围	-40 ~ 85℃
贮存温度范围	0 ~ 40℃

说明:

- 1.最大额定值为晶能光电封装条件下测试得到,不同封装形式得到的值会有所不同,建议在不超过最大额定值的条件下使用,超过最大额定值使用可能会引起LED芯片毁坏。
- 2.本产品非设计与逆向电流(压)下使用,不建议在任何逆向电流(压)下使用。

## 产品特点:

- 1、垂直结构,打线少,可靠性高
- 2、硅衬底结构,散热性好

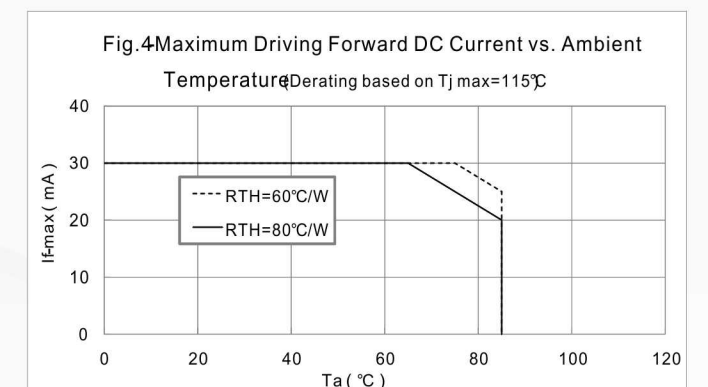
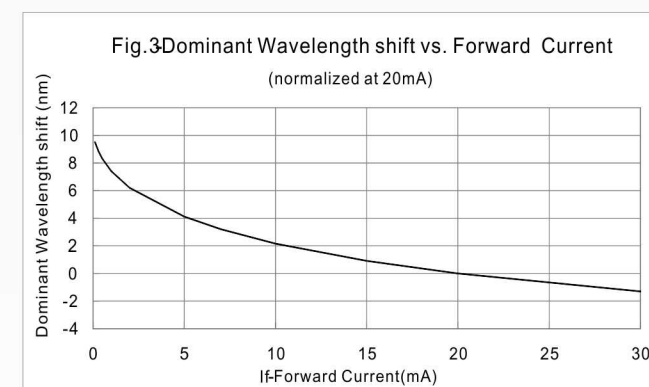
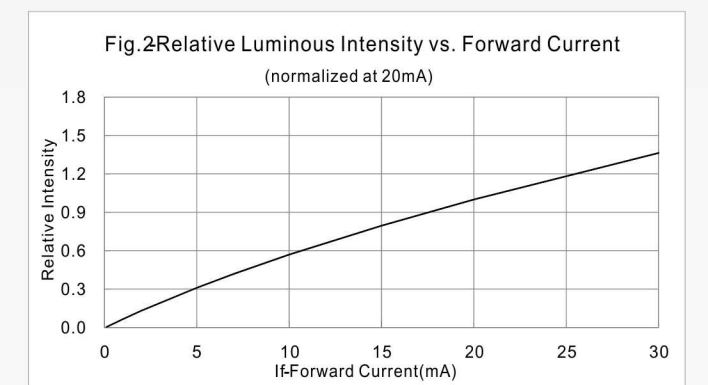
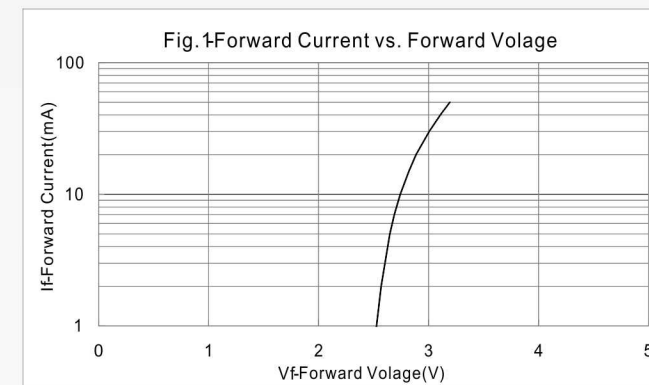
## 产品应用:

- 1、户内、户外显示屏

## 光电参数:

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
开启电压	Vf1	If=10μA	2.1	---	2.8	V
工作电压	Vf2	If=20mA	2.8	---	3.6	V
反向漏电流	IR	Vr=8V	---	---	1	μA
主波长	λd	If=20mA	460	---	475	nm
半波宽度	Δλ	If=20mA	---	---	30	nm
光强	Iv	If=20mA	30	---	125	mcd

## 特性曲线



## 其它说明:

1. 光电参数为采用晶能光电测试仪器在室温下(TA=25℃)测试结果;
2. GaN芯片为静电敏感产品,请在使用、运输时注意静电保护;
3. 可根据客户要求订做特殊规格芯片;
4. 最大额定值与封装方式有关;
5. 该产品通过静电1200V(人体模式)全测试;
6. 封装注意事项:请参照《硅基LED芯片使用指南》。

LatticePower